

电子行业跟踪周报

国产算力周跟踪：超节点规模落地刚起步，竞争转向系统级整合能力

增持（维持）

2026 年 10 月 18 日

证券分析师 陈海进

执业证书：S0600525020001

chenhj@dwzq.com.cn

投资要点

- 产业落地持续推进，国产超节点规模化部署刚刚开始，竞争焦点从“有没有单卡”转向“系统整合能力”。

近期国产算力产业侧进展密集：昇腾 950DT 万卡池、千卡超节点相继在运营商侧落地，华为云灵衢昇腾 950 智算集群于 9 月 30 日在国内商用；IDC 数据显示上半年国产加速卡份额继续提升，产业链三季报业绩预告陆续披露。

国产超节点仍处在规模落地的早期，后续比拼的是系统级整合能力。从 384 卡到 8192 卡，从单柜到万卡集群，从电互连到 NPO/CPO，技术路线仍在快速迭代。单卡硬件参数的差距正在收窄，真正决定实际产出的是算力的调用效率，即 infra 能力。因此竞争的关键不再是“有没有国产卡”，而是芯片、互连、光电合封、先进封装、供电散热与调度软件的协同优化，比拼的是集群的有效算力、互连效率和单位 Token 成本。能在系统层面持续提效的环节，价值量和话语权都将继续抬升。

- 算力芯片：业绩集中兑现，国产份额提升，HBM 仍是供给约束。

海光信息预计前三季度归母净利润 27.10–29.80 亿元，同比+38%至+52%；推算 Q3 单季归母 9.12–11.82 亿元，同比+20%至+56%，营收 51.8–64.8 亿元，同比+29%至+61%。沐曦股份前三季度扭亏，归母 5.87–7.17 亿元，营收同比+106%至+151%；推算 Q3 单季营收 12.2–17.8 亿元，同比+279%至+455%，扣非约 2.7–3.5 亿元，主业利润转正。据 IDC，2026 年上半年中国 AI 加速器市场总出货 200.8 万颗，其中英伟达 67.8 万颗，份额 34%，同比-44%；华为 57.2 万颗，份额 28%；平头哥、寒武纪、昆仑芯、海光分别为 7%、5%、4%、3%，11 家国产厂商中有 9 家出货同比增长。

单卡天花板受制程与存储双重约束，“系统换性能”是国产算力的必然路径。今年下半年以来 HBM 供应持续紧张，国内厂商的 HBM 获取渠道受限、采购成本明显抬升，也制约了部分产品的出货节奏。国产 HBM 的量产爬坡进度，是后续国产卡供给能否进一步释放的核心变量。

建议关注：海光信息、寒武纪、沐曦股份、中芯国际、长鑫科技等。

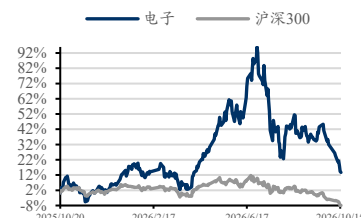
- 超节点：昇腾 950 进入规模落地，系统厂商业绩同步高增

10 月 16 日，中国电信与华为在内蒙古落地全球首个昇腾 950DT 万卡池，中国移动在北京落地昇腾 950DT 千卡超节点；华为云灵衢昇腾 950 智算集群于 9 月 30 日在国内商用，计划 11 月 30 日推向海外。华为超节点规模已从 384 卡升级至 8192 卡，下一代 960 超节点首发 NPO 方案，可扩展至 4096 卡。天数智芯 10 月 12 日发布天垓 300 IXL144，单柜集成 144 颗 GPU 与 18 颗 CPU，公司测算每百万 Token 成本较海外主流方案下降 40%。

业绩端，浪潮信息预计前三季度归母 38–41 亿元，同比+156%至+177%，推算 Q3 单季 8.48–11.48 亿元，同比+24%至+68%；中科曙光发布前三季度归母 17.24 亿元，同比+78.5%，推算 Q3 单季归母 7.53 亿元，同比+217%，营收 47.73 亿元，同比+61%，利润中含对海光信息的投资收益；紫光股份预计前三季度归母 24.2–30.6 亿元，同比+72%至+118%，推算 Q3 单季 2.53–8.93 亿元。

竞争维度已从单卡参数转向单柜密度和单位 Token 成本。超节点把算

行业走势



相关研究

《端侧 AI 周跟踪：个人 Agent 加速普及，终端应用需求增长驱动 AI 硬件升级》

2026-10-11

《海外算力周跟踪：AI 硬件产业链持续高景气，看好 Q4 业绩高增》

2026-10-07

力单元从单卡扩展到整机柜乃至集群，竞争力取决于系统集成、互连调度和交付能力。整机与 ODM 厂商作为系统集成的承载方，直接受益于规模化部署。

建议关注：华勤技术、浪潮信息、中科曙光等。

■ 互连：海外开放 Scale-up 路线推进，自主可控采购比例提升

OCP 峰会上，AMD 展示 Helios 机架级系统，集成 72 颗 MI455X，采用 UALink 和 Ultra Ethernet；Meta 介绍面向 MTIA 的以太网 Scale-up 交换机 Tahan；微软与 Meta 介绍 ESUN 开放 Scale-up 网络；英伟达向 OCP 开放了 Vera Rubin 机架及计算托盘的设计规范，ODM 和云厂商可据此设计兼容机架。国内方面，中国移动启动 RoCE 交换机集采，共 2450 台，自主可控占比由上一次的 73% 以上提升至 80%，两个标包合计最高限价超 40 亿元。

超节点规模越大，卡间互连越决定集群的有效算力。海外在英伟达 NVLink 封闭体系之外，正形成以 UALink、Ultra Ethernet、ESUN 为代表的开放 Scale-up 路线；国内则并存“自研私有协议”与“开放以太网”两条路线——华为灵衢、阿里 ICN 等大厂自研协议自成封闭体系，而第三方以太网方案提供开放、标准化的替代选择，方向与海外开放趋势趋同。国产 Scale-up 可期，但需持续跟进两大变量：一是高带宽产品的进展——时延、内存语义、与 GPU 厂商联合设计是核心门槛；二是客户实际导入进度——需通过大厂认证、进入整机柜核心供应链。短期吃 Scale-out 格局变化，中期看 Scale-up 市场增量，长期看第三方独立供应商份额上限。

建议关注：盛科通信、锐捷网络、星网锐捷等。

■ 光互连：CPO 从器件验证走向整机运行，互连成为硬约束

OCP 峰会上，纬颖联合 Ayar Labs、创意电子，将 ASIC、光引擎与外置光源集成于同一计算系统，实现光链路稳定运行；Celestica 发布基于 Tomahawk 6-Davisson 的 102.4T CPO 交换机，支持 64 个 1.6T 端口；Lightmatter 与 Flex 展示 204.8T CPO 托盘，处于生产验证阶段；可插拔 NPO 专题研讨会上，华为、阿里参与了架构与标准化讨论。Lumentum CEO 表示，公司光器件已“完全售罄”，订单排至 2029 年初，部分产品明年仍有约 70% 的需求无法满足。光迅科技预计前三季度归母 11.89–13.10 亿元，同比+65%至+82%。

光电转换向芯片靠近，价值量向光引擎和合封环节迁移。CPO/NPO 缩短电信号传输距离、降低功耗，同时对光电耦合、外置光源、精密组装和测试提出更高要求，价值量从可插拔模块向光引擎、激光源、FAU/微光学、光电合封等环节迁移。这些环节的协同优化，直接决定集群的互连速率和功耗。

建议关注：光迅科技、源杰科技、长光华芯、晶方科技等。

■ 先进封装：CoWoS 扩产外溢到第三方，玻璃基板进入验证期

台积电 10 月 15 日法说会表示，5 倍光罩尺寸先进封装已投入生产、良率良好，9 倍和 14 倍规格正在推进；格芯与台积电达成约 20 亿美元的多年期协议，扩建纽约工厂硅中介层产能，为 CoWoS 提供配套。玻璃基板方面，英伟达正在评估下一代 GPU 采用玻璃基板，TGV 金属化与客户认证仍是主要难点；京东方玻璃基载板试验线设计产能每月 1k 片，20 层样品已通过多项可靠性测试；通格微与华工科技合作开发 3.2T 光模块玻璃基载板；博杰股份的 TGV 激光钻孔设备已通过客户初步验收。

制程受限下，先进封装是提升单芯片能力的主要途径，也是系统整合的物理基础。AI 芯片集成的计算芯粒和 HBM 数量持续增加，封装尺寸与互连密度同步提升，CoWoS 扩产已从台积电自身延伸到硅中介层等外部环节。玻璃基板短期看 TGV 工艺突破和良率提升，中长期看在大尺寸 AI 封装中的量产应用。

建议关注：通富微电、长电科技、盛合晶微、甬矽电子、芯碁微装、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测等。

- **风险提示：**云厂商资本开支不及预期；先进制程与 HBM 供给不及预期；海外技术路线与出口政策变化；CPO/NPO 量产进度不及预期；行业竞争加剧。

免责声明

东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供符合中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者使用,且接收人须为本公司认定并建立服务关系的专业机构投资者使用,本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。本报告不面向普通投资者发布或传播。任何非专业机构投资者收到本报告后,应立即退回并销毁,不得依据本报告内容做出任何投资决策。

在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的,应当注明出处为东吴证券研究所,并注明本报告发布人和发布日期,提示使用本报告的风险,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的,应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期(A 股市场基准为沪深 300 指数,香港市场基准为恒生指数,美国市场基准为标普 500 指数,新三板基准指数为三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的),北交所基准指数为北证 50 指数),具体如下:

公司投资评级:

买入: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上;

增持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间;

中性: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间;

减持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间;

卖出: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级:

增持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对强于基准 5%以上;

中性: 预期未来 6 个月内,行业指数相对基准-5%与 5%;

减持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况,如具体投资目的、财务状况以及特定需求等,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码: 215021

传真: (0512) 62938527

公司网址: <http://www.dwzq.com.cn>